

Donnerstag, 27. September 2018

ab 08:00

Anmeldung und Besuch der Ausstellung

08:30

Eröffnung der Konferenz und Begrüßung

Prof. Dr. Rainer Thüringer, Vorstandsvorsitzender des FED

08:40

Keynote: Künstliche Intelligenz in der Fertigung

Prof. Dr.-Ing. Sami Haddadin, Roboterforscher und Experte für künstliche Intelligenz

09:45

PAUSE FÜR GESPRÄCHE UND NETZWERKEN IN DER AUSSTELLUNG

10:30

MANAGEMENT

Unternehmenserfolg durch zeitgemäßen B2B-Vertrieb: Vertriebsexzellenz für den Mittelstand

Holger Steitz
Verkaufstrainer

ENTWICKLUNG & DESIGN

HDI kostengünstig einsetzen: Wie das Design die Kosten beeinflusst und Kostentreiber eliminiert werden

Harald Antonitsch
AT&S

FERTIGUNG & TEST

RFID im PCB: Smarte Leiterplatten mit eingebetteter RFID steuern die Elektronikfertigung 4.0 – Praxisbericht

Alexander Schmoltd
Murata

MULTIFUNKTIONALE LEITERPLATTEN

Klett-Welding: elektrisches Kontaktieren von Bauteilen bei Raumtemperatur über Nanodrähte

Olav Birlem
NanoWired

11:15

Social Media Marketing im B2B: nachhaltige Leadgenerierung und Recruiting

Sanjay Sauldie
Digital Business Consultant

Leiterplattendokumentation vom Material bis zum Nutzen – was der Leiterplattendesigner liefern muss

Martin Sachs
db electronic

Traceability in der Kleinserienfertigung: Chancen permanenter Datenerhebung und -analyse

Andreas Kraus
Kraus Hardware

Massenfertigung von energieautarken thermoelektrischen Generatoren für das Energy Harvesting

Matthias Hecht
otego

12:00

MITTAGSPAUSE – GESPRÄCHE UND NETZWERKEN IN DER AUSSTELLUNG

13:15

Führen ohne Vorgesetztenfunktion in Teams und Projekten

Torsten Graßmeier und
Theo Veltkamp, Trainer
für Projektmanagement und
Führung

Modulares Multiboard Design am Beispiel Elektromobilität mit hohen Spannungen und maximaler Stromtragfähigkeit

Ralf Brüning und
Herbert Ritthaler, Zuken

Die Chancen der Digitalisierung für zukunftssichere Baugruppenfertigung nutzen

Jürgen Friedrich
KurtzErsa

Dreidimensionale Aufbau- und Verbindungstechnik auf Keramikbasis

Dr.-Ing.Uwe Partsch
Fraunhofer-Institut für
Keramische Technologien
und Systeme IKTS

14:00

Werkzeuge zur gezielten Entlastung vom Alltagsdruck in Beruf und Privatleben

Dr. Wolfgang Dietrich
SABINE DIETRICH & Co.

Verständliche Design Rule Checks für DFM, DFA, DFT, SI und PI

Dirk Müller
FlowCAD

Warum Fertigungsausrüster heute mit ihren Kunden entlang von Produktions-Workflows Lösungen für die smarte Fabrik entwickeln

Oliver Kraus, ASM

Vom Design zur geprüften 3D-Baugruppe: NPI/Industrialisierung von 3D-Elektronik

Michael Matthes
Wittenstein

14:45

PAUSE FÜR ERFRISCHUNGEN, GESPRÄCHE UND BESUCH DER AUSSTELLUNG

15:30

Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung im BGB erhöht Haftungsrisiko in der Lieferkette

Kai-Oliver Giesa
Rechtsanwalt

Hardware und Firmware agil entwickeln: Agile Hardware – aber wie? Ein Erfahrungsbericht aus der Praxis

Mario Blunk
Blunk electronic
und

Dr. Tobias Kästner
Method Park Engineering

Solder Limits: Updating UL Recognized PCBs for the Age of Surface Mount

Emma Hudson
UL

Multiboard, Embedded, Flex-/Starrflex, MID ... Wie ist die EDA-Welt für das Design von 3D-Technologien gerüstet?

Anbieter von EDA-Tools zeigen in Kurzpräsentationen ihre 3D-Features. Im Anschluss können alle Teilnehmer ihre Fragen in einer moderierten Diskussion an die EDA-Experten richten.

16:15

Datenschutzrisiken für Unternehmen mit Inkrafttreten der DSGVO

Ralf Wickert
Rechtsanwalt

Die neue UL: Konsequenzen für Leiterplattenhersteller und Baugruppenfertiger

Diskussionsleiter:
Jürgen Deutschmann, AT&S

17:00

17:30

Geführte Tour durch die Bamberger Altstadt – Motto: Faszination Weltkulturerbe

19:30

Empfang und Einlass zur Abendveranstaltung

20:00

Abendveranstaltung im Hegel-Saal mit der Verleihung des PCB Design Awards

Freitag, 28. September 2018

ab 08:00

Anmeldung und Besuch der Ausstellung

08:30

Eröffnung des zweiten Konferenztages

Prof. Dr. Rainer Thüringer, Vorstandsvorsitzender des FED

08:40

Hurricane Management – Schubhebel für die Unternehmenskultur im 21. Jahrhundert

Peter Brandl, Berufspilot, Fluglehrer, Managementberater

09:45

PAUSE FÜR GESPRÄCHE UND NETZWERKEN IN DER AUSSTELLUNG

10:30

MANAGEMENT

Die Chancen von Digitalisierung und Standardisierung für deutsche Fertiger von Musterbaugruppen

Jan Marloth, Becktronic und Felix Plitzko, AISLER

ENTWICKLUNG & DESIGN

Hardware für das Internet der Dinge (IoT) – Anforderungen an die Vernetzung von Geräten und Sensoren

Klaus Rupprecht
SYS TEC electronic

FERTIGUNG & TEST

Prozessanforderungen für die Verarbeitung von Bauteilen mit 250 µm Pitch

Rainer Taube
TAUBE ELECTRONIC

MULTIFUNKTIONALE LEITERPLATTEN

Embedding von HF-Komponenten für hochgenaue HF-Antennen

Thomas Gottwald
Schweizer Electronic

11:15

IT-Sicherheit für die digitale Industrie: ganzheitliche Ansätze für KMU

Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie SIT

Entwicklung ganzheitlicher Systemlösungen und zukünftige Anforderungen an Industriedisplays und MMI

Patrick von Unold
Data Modul

IPC-A-600 / IPC-A-610 - Fehlerbilder aus der täglichen Praxis der Leiterplattenanalyse

Thomas Kuhn
HTV

SMD-Embedding für kleine und mittlere Stückzahlen am Beispiel eines 8-Kanal-Multiplexers

Johannes Blum
ILFA

12:00

MITTAGSPAUSE – GESPRÄCHE UND NETZWERKEN IN DER AUSSTELLUNG

13:15

Die Chancen verzahnter IT-Systeme und Automatisierung der Lieferkette für Baugruppenkalkulation und Angebotserstellung, Bauteilebeschaffung und Stammdatenpflege sowie der Umgang mit Bauteilverfügbarkeit und Allokation

Statements und Diskussion:
Thomas Kaiser, CCS
Dr. Marc Schacherer, Farnell
Dirk Müller, FlowCAD
Helmut Krautwurm, Bay-Soft

Design for Reliability oder wie kann der Entwickler die Leiterplattenzuverlässigkeit beeinflussen

Helge Schimanski
Fraunhofer ISIT

Voids und Lunker und deren Einfluss auf die Lebensdauer RoHS-konformer Lötverbindungen

Lutz Bruderreck
TechnoLab

Die Zukunft der Leiterplatte: integrierte Funktionen, neue Materialien, Marktzyklen, disruptive Einflüsse

Marc Nikutowski
NCAB Group

14:00

Design for Inspectability: Empfehlungen für die 100%ige Inspizierbarkeit von Baugruppen

Michael Mügge
Viscom

Einflussfaktoren im SMD-Prozess und die Wahrscheinlichkeit der Bildung von Voids und Lunkern

Dr.-Ing. Heinz Wohlrabe
TU Dresden

Dreidimensionale Elektronikmodule: ressourcenschonende Fertigung individualisierbarer Produkte

Ulf Oestermann
Fraunhofer IZM

14:45

PAUSE FÜR ERFRISCHUNGEN, GESPRÄCHE UND BESUCH DER AUSSTELLUNG

15:15

Wertstromorientiertes Prozessmanagement – best practice Lean Management in der Elektronikfertigung

Christoph Heuser und Rudolf Dörr, FEIG ELECTRONIC

Aktive Stücklisten und verknüpfte Dokumentation für Qualität, Genauigkeit und Umsetzbarkeit

Christian Keller
Altium

Neues Prüfverfahren vermeidet „Fake Tests“ und garantiert die Qualität von Testprogrammen

Hans Baka
Digitaltest

IML SmartWave Panels: dreidimensional geformte Kunststoffbauteile mit integrierter Elektronik

Christoph Ernst
Kunststoff Helmbrechts

16:00

Optimieren der Baugruppenentwicklung durch Verringerung des Time-to-Market

Jens Arnold
breflex electronic

Automatisierte Leiterplatten-Kriechstromanalyse in 2D und 3D

Christos Fontounasios
Mentor

Optimierte Handbestückung unter Einsatz einer Datenbrille – Praxisbericht zum BMBF-Projekt OptED

Jeannine Budelmann
Budelmann Elektronik

Neue Ansätze zur Herstellung mechatronischer Module

Prof. Dr. Herbert Reichel, Hochschule Hof, und Prof. Dr. Marcus Reichenberger, TH Nürnberg

16:40

16:45

Verabschiedung der Konferenzteilnehmer in der Ausstellung und Ausblick 2019

Prof. Dr. Rainer Thüringer, Vorstandsvorsitzender des FED